

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《關於間接控股股東增持股份計劃進展公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二三年十月十七日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

孫國棟

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

A 股代码：688347

A 股简称：华虹公司

公告编号：2023-007

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于间接控股股东增持股份计划进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 增持计划主要内容：华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内，通过集中竞价的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。
- 增持计划的实施情况：2023 年 8 月 30 日至 2023 年 10 月 17 日，华虹集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 543,001 股，合计增持金额人民币 2,508.50 万元（含交易费用），已超过本次增持计划下限金额人民币 5,000 万元的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，华虹集团将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
- 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：上海华虹（集团）有限公司

（二）截至增持计划公告前，华虹集团通过其全资子公司 Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司）间接持有公司 347,605,650 股股份，占公司股份总数的 20.25%，为公司的间接控股股东。

（三）本次公告披露之前 12 个月内，华虹集团未披露过其他增持计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的及方式

公司间接控股股东华虹集团基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟通过集中竞价的方式增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的金额

本次拟增持股份合计金额不低于人民币 5,000 万元且不高于人民币 10,000 万元。

（三）本次拟增持股份的价格

本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

（四）本次增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增持计划顺利实施，本次增持股份计划的实施期限为自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）本次拟增持股份的资金安排

华虹集团拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

（六）本次拟增持股份的方式

华虹集团通过集中竞价的方式增持公司股份。

三、增持计划的实施进展

2023 年 8 月 30 日至 2023 年 10 月 17 日，华虹集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 543,001 股，合计增持金额人民币 2,508.50 万元（含交易费用），已超过本次增持计划下限金额人民币 5,000 万元的 50%。

本次增持计划尚未实施完毕，华虹集团将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2023年10月18日